

深圳市江波龙电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-014

| | |
|-------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | CLSA HK、China Pinnacle Equity Management Limited、 Taikang Insurance Group Inc.、Khazanah Nasional Berhad、 Abu Dhabi Investment Authority、Oaktree Capital Management, L.P.、Balyasny Asset Management (Hong Kong) Ltd.、Man Group、FountainCap Research、Mega Prime Development Limited |
| 时间 | 2024年9月13日(周五) 下午 16:00~17:00 |
| 地点 | 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春 |

| | |
|---------------------------|---|
| <p>投资者关系活动 主要内容介绍</p> | <p>1、如何理解公司近期提出的二次增长曲线概念？</p> <p>答：目前，公司的增长动力正在从消费类存储业务切换至车规级、工规级与企业级等高端存储器领域，主要体现在如下几个方面：1）在企业级产品领域，公司是国内少数具备“eSSD+RDIMM”的产品设计、组合以及持续供应能力的企业，并在互联网、运营商、金融等行业的众多客户处完成产品验证和批量应用。2）在主控芯片领域，公司已经推出了 eMMC 和 SD 卡主控芯片（已经实现超千万颗的产品应用），并匹配自研固件算法，能够高效率满足客户的产品性能要求，增加大客户黏性；3）公司拓展了 SLC NAND Flash 等小容量存储芯片设计能力，实质性构建了自研 SLC NAND Flash 存储芯片设计业务，产品获得客户认可，累计出货量已远超 5000 万颗。</p> <p>总体而言，公司将在保持嵌入式存储及移动存储等基础业务的领先技术和规模优势的前提下，加大对高毛利产品的研发和投入，如企业级、工规级等高端存储器领域，不断优化客户结构，完善产业链布局，进一步凸显差异化竞争优势，实现业务规模和收入的不断增长。</p> <p>2、公司车规级存储业务未来展望？</p> <p>答：在新能源汽车的带动下，智能驾驶、智能座舱的持续渗透，将为车规级存储的发展提供新的动力，整体市场规模有望持续增长。而随着“车路云一体化”技术的推进，自动驾驶车辆需要处理更大规模数据，存储设备需具备更高的速度、容量和耐用性，以支持实时的数据分析和存储，这将显著增加对高性能存储解决方案的需求，并带动车规级存储市场和相关技术需求的新一轮的增长。</p> <p>公司作为业内较早进入车规级存储领域的企业，率先在中国大陆发布车规级 UFS 和车规级 eMMC，并构建了涵盖 UFS、eMMC 和 SPI NAND Flash 在内的车规级存储产品矩</p> |
|---------------------------|---|

阵。公司具备自研主控结合自研固件以及自主封测的自主可控能力，目前已服务超过 20 家中外头部汽车品牌客户，覆盖了包括 DVR、ADAS、座舱、IVI、仪表和 T-box 在内的 10 余种车载应用，享有超过 8 年量产服务经验，充分发挥车载存储发展先机。

3、公司各产品线营收占比情况？

答：嵌入式存储业务依然是公司主力，是销量及毛利的主要贡献来源；典型的移动存储业务将保持稳定的业务占比；基于公司企业级存储产品的推出，叠加信创行业复苏所带来的双重驱动，今年公司固态硬盘业务占比将呈现稳步上升的趋势；最后是内存条业务，今年其营收占比预计保持稳中有升。

未来，随着公司在车规级、工规级与企业级等高端存储器领域的持续发力，以及产品结构及客户结构的不断优化，嵌入式存储业务占比将有所下降。

4、目前公司主控芯片业务及封测业务分别占公司多少产能？

答：在可控芯片领域，公司两款自研主控芯片（WM6000、WM5000）已经批量出货，并已经实现了超千万颗的规模化产品导入，收到了良好的效果。

在封测领域，公司的半导体存储器产品的封测加工及制造工序，存在外发产能及自有产能。公司 2023 年完成了对巴西 Zilia 以及元成苏州的控制型收购以及整合后，公司具备了在外发以及自有产能之间进行灵活调整的空间。公司未来将视业务发展的情况、客户的需求，以及产品本身的特点，适当地分配相当比例。

5、如何看待未来存储价格及下游市场需求情况？

答：在经历了 2023 年年末至 2024 年第二季度前期的存储价格大幅普涨的浪潮后，未来存储价格将再难以一概

| | |
|----------|--|
| | <p>而论，而是会根据不同的应用场景呈现结构性分化趋势。各原厂都在努力将产能重心转移至服务器市场的高价值产品领域。</p> <p>在需求端，云服务提供商对 AI 硬件的持续投资，推动了对高性能计算和存储硬件的强劲需求，服务器领域的高速、大容量存储产品需求显著增长。除服务器外，手机、PC 等重要下游市场需求在 2024 年逐步回暖。此外，随着 AI 技术从云端逐步向终端设备落地，终端设备的处理能力和数据存储需求显著提升，单机存储容量逐渐增加，将进一步推动了相关领域的中长期需求增长。</p> <p>在需求整体增长和供应趋紧的双重作用下，2024 年整体来看，半导体存储行业总体还在上行周期，但是不同应用场景的结构性分化将会越来越明显。相较于消费类存储产品因价格上涨而导致上下游陷入博弈，车规工规以及企业级服务器存储产品为主的高性能存储产品需求持续旺盛。这一新的产业趋势，为具备高端产品及服务能力等核心竞争力的企业创造了新的增长空间和发展动力。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |